



半導体封止材料の設計・製造技術 総合解説 ～2か月連続コースセミナー～

2名同時に
申込みで
1名分無料
※適用される範囲等、詳細は
ホームページをご覧ください

| | | | | | |
|-----|----|----------------------------|----|-------------------------------|--------|
| 基礎編 | 日時 | 2019年11月11日(月) 10:30～16:30 | 会場 | 東京・港区浜松町 芝エクセレントビル B1F KCDホール | 資料・昼食付 |
| 応用編 | 日時 | 2019年12月12日(木) 10:30～16:30 | 会場 | 東京・品川区大井町 きゅりあん 4F 研修室 | 資料・昼食付 |

講師 (有)アイパック 代表取締役 越部 茂 氏

趣旨 半導体は、「樹脂封止」の採用(1970年代後半)により急成長を遂げ汎用化した。日本は、樹脂封止用の「封止材料」の分野で市場を制圧し続けている。今回、封止材料の基本技術および応用技術を、2日間にわたり徹底解説する機会を設けた。講師は、封止材料およびその関連技術の開発に最前線で現役として約40年携わっている。
1日目の講義では、封止材料の基本技術を、2日目の講義では応用技術を分かり易く説明する。今後も、封止材料の成長は続く予想されるが、これまでの開発経緯や要素技術の伝承が危惧されている。また、近年パッケージ方法の進展に伴って新たな形態の封止材料も検討されており新たな材料開発に期待がかかっている。本講演では、2日間の講義を通じて、半導体パッケージング関係者への技術伝承とともに今後の開発指針について議論したい。

基礎編 「～基本を押さえて設計・開発・活用の糧に～ 半導体封止材料の基礎から組成・原料・製造・評価方法まで」

| | | |
|--------------|---|--|
| プログラム | 第1講 封止材料の基本理解 1. 封止材料の基礎 2. 封止材料の基本組成 3. 封止材料の製造諸元 4. 封止材料の製造諸元 | 第2講 封止材料の構成原料の種類・役割と 選定・使用方法の基本 6. 封止材料用シリカ 7. 封止材料用エポキシ樹脂 8. 封止材料用硬化剤 9. 封止材料用硬化触媒 10. 封止材料用機能剤 11. 封止材料用他原料 |
| | □ 質疑応答 □ | |

応用編 「～応用技術を押さえて機能化設計・先端デバイス適用への糧に～ 半導体封止材料の配合設計・製造応用技術と先端パッケージ対応」

| | | |
|--------------|--|---|
| プログラム | 第1講 封止材料設計・製造の応用技術 ～シリカ・触媒・機能剤配合～ 1. シリカ配合と封止材料特性との関係 2. シリカの表面処理技術 3. シリカの分散技術 4. シリカの課題 5. 触媒の活性制御 6. シラン系処理剤の活用技術 7. シランカップリング剤処理技術 8. 他の機能剤の活用技術 | 第2講 先端パッケージで求められる封止技術の概要 (半導体パッケージング技術の進化への対応) 9. 半導体パッケージング技術開発の動き 10. IT分野と封止技術 11. 自動車分野と封止技術 |
| | □ 質疑応答 □ | |

受講料 82,500円(税込) ⇒ S&T会員 78,370円
(定価: 本体75,000円+税7,500円 会員: 本体71,250円+税7,120円) ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 ※申込用紙「通信欄」にご希望のコースをチェックしてください。

【1日選択受講価格】
49,500円(S&T会員受講料 47,020円) 定価: 本体45,000円+税4,500円 会員: 本体42,750円+税4,270円

【2名同時申込みで1名分無料】
(1名あたり定価の半額 2日選択受講: 41,250円 1日選択受講: 24,750円)
※2名様ともS&T会員登録をいただいた場合に限りです。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※他の割引は併用できません。

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 S191199 (封止材料 基礎+応用)

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--|----|--|
| 会社名 団体名 | | | 〒 | |
| 部署 | | | 住所 | |
| 役職 | | | | |
| ふりがな | | | | |
| 氏名 | | | | |
| TEL | FAX | | | |
| E-mail | ※申込みに関係する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。 | | | |

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内

E-mail希望・登録済み) S&T会員価格を
 郵送希望・登録済み) 適用いたします。
 希望しない) (E-mailアドレス必須)

お支払方法

銀行振込 (振込予定日 月 日)
 当日現金払い

通信欄

基礎編 応用編

●受講料について 「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて 受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。振込手数料はお客様がご負担ください。
●個人情報の取り扱いについて ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定 開催日から逆算(営業日: 土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前でのキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

S&T サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
http://www.science-t.com